

高周波基板

IoT, 5G, 自動運転とますます
高まる高周波基板のご要求に
貢献します。

Thank you for visiting
the AT&S booth.
Visit ats.net for more
information.



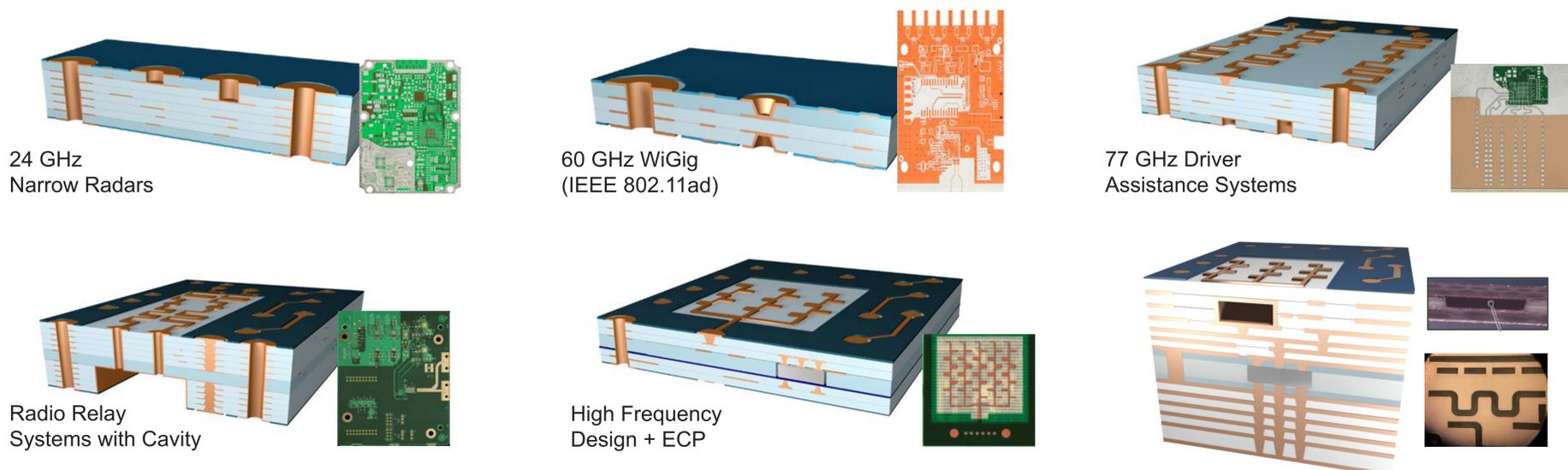
General design rule

Layer count	4 - 28 layers
Thickness	0.32 - 2.4 mm
Stack-up	Core & Hybrid Build up
Material	Epoxy based, PTFE, PPE, LCP, Ceramic
Co foil thickness	9μm / 18μm / 35μm / 70μm
Line/Space	50μm / 50μm
Smallest mech. Φ	0.15 mm
Surface finish	<ul style="list-style-type: none"> OSP / HAL Lead Free / Immersion Tin Immersion Ni/Au, Plated Ni/Au Immersion Ag
Plating	Panel Plating Pattern Plating

デザインルール

層数	4 - 28 layers
板厚	0.32 - 2.4 mm
層構成	対称/非対称の貫通、ビルドアップ
基材	Epoxy based, PTFE, PPE, LCP, Ceramic
銅箔厚	9μm / 18μm / 35μm / 70μm
ライン/スペース	50μm / 50μm
最小ドリル径	0.15 mm
表面処理	<ul style="list-style-type: none"> OSP / 鉛フリーレベラー/無電解スズ 無電解金/電解金 無電解銀
めっき方法	パネルメッキ パターンメッキ

Various layer configurations / 多種多様な層構成

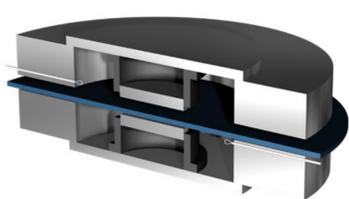


Cross section of AFWG with structured copper for wave feeding on bottom
Flexibel & scalable Waveguide Design

Measurement technology and know-how 測定技術及びノウハウ

Dk/Df measurement at 1 / 5 / 10 / 15 GHz
by SPDR (Split Post Dielectric Resonator)

1/5/10/15GHz帯のDk/Df値



Measurement of transmission loss and delay time
at up to 100 GHz by Network Analyzer

伝送損失/遅延(~100GHz)

